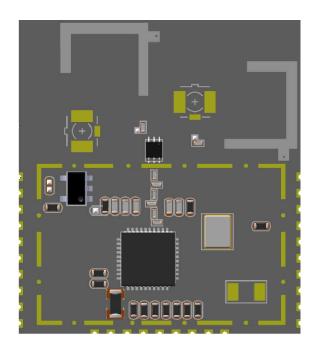


# 蓝牙模块规格书

# HM-BT2401DA





# 目录

1	产品概述	3
2	模块特点	3
3	电气特性	4
	模块功能说明	
	应用示意图	
6	模块引脚	5
	6.1 模块引脚分布	5
	6.2 模块引脚定义	6
7	模块尺寸	8
8	硬件设计注意事项	8
9	常见问题	10
	9.1 传输距离不理想	10
	9.2 易损坏——异常损坏	10
	9.3 误码率太高	10
1(	)回流焊条件	11
1	静电放电警示	11
12	2 文档变更记录	12
13	3 联系方式	12



#### 1 产品概述

HM-BT2401DA 是一款基于 SoC 芯片设计的高性能 BLE6. 0 信道探测 (Channel Sounding) 模块,支持启动器(Initiator)和反射器(Reflector)角色,集成 PCB 双天线及可外接双天线实现高精度测距性能。模块凭借高性能 2. 4 GHz 射频、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和安全保险库等关键功能,也是低功耗蓝牙和 mesh 无线连接通讯的理想选择,物联网设备制造商可以创建智能、强大、节能的产品,免受远程和本地网络攻击。模块资源丰富,性能强大,支持二次开发。基于特定的产品固件,通过与外部 MCU 进行通信,轻松实现模组配置和无线数据的透传,同时支持 BLE 主从角色,既可以作为主机扫描连接从机 BLE 设备,又可以作为从机快速实现与手机、平板等 BLE 主设备的无线连接和数据通信,外部 MCU 资源占用低,开发过程简单。

#### 2 模块特点

- 高性能 32 位 ARM Cortex®-M33, 工作频率为 78 MHz 带有 DSP 指令和浮点单元,可实现高效的信号处理;
- 高达 1024KB 的 FLASH 程序存储器和 128KB 的 RAM 数据存储器
- 多种协议支持包括低功耗蓝牙、蓝牙 MESH、私有 2.4G 协议和信道探测
- 蓝牙信道探测(Channel Sounding)功能支持 RTT(往返时间)和 PBR(基于相位的测距)模式
- 支持启动器 (Initiator) 和反射器 (Reflector) 两种测距角色
- 支持高达 72 信道的标准及随机跳频模式
- 板载支持双天线路径



#### 3 电气特性

- 工作电压: 1.71V-3.8V
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 调制模式: GFSK 高斯频移键控
- 调制频率: 2400MHz 2483.5MHz
- 最大发射功率: +10dBm
- 接收电流: 4.4mA @1Mbps
- 发射电流: 5.0mA @OdBm
- 发射电流: 19.1mA @10dBm
- 接收灵敏度: -97.6dBm @1Mbps
- 低功耗模式电流: 33.4uA/MHz in Active Mode (EMO)@39.0MHz
- 深度睡眠模式: 1.3uA @EM2 Deep Sleep

#### 4 模块功能说明

模块启动后会自动进行广播,打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和连接,成功连接后可通过 BLE 协议对其进行操作。外部 MCU 可以通过模块的串口与移动设备进行双向通讯,外部 MCU 也可以通过串口,以及控制指令,对模块的通信参数进行控制。

用户数据格式由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行 写操作,写入的数据将通过模块接口发送给外部 MCU。模块接口收到外部 MCU 的数据包后,将自动转发给已经连接的移动设备。用户需要完成外部 MCU 的代码设计以及移动设备的 APP 代码设计。



## 5 应用示意图

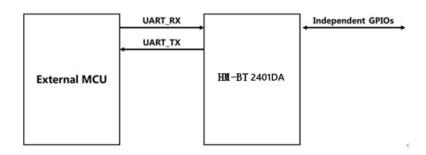


图 1 透传模块应用示意图

## 6 模块引脚

# 6.1 模块引脚分布

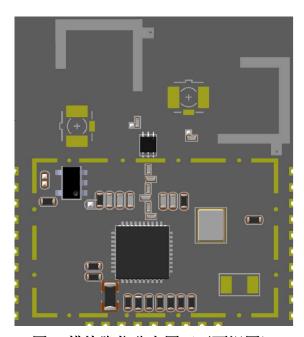


图 2 模块脚位分布图(正面视图)



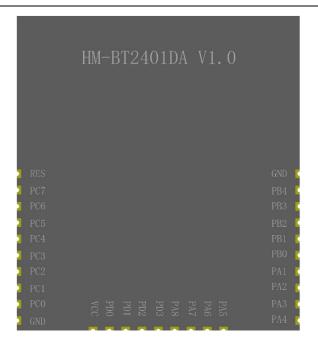


图 3 模块脚位分布图(背面视图)

# 6.2 模块引脚定义

Pin No	Pin Name	Туре	Description	
1	GND	DG	电源地	
2	PB4	I/0	通用 GPIO	
3	PB3	I/0	通用 GPIO	
4	PB2	I/0	通用 GPIO	
5	PB1	I/0	通用 GPIO	
6	PB0	I/0	通用 GPIO	
7	PA1	I/0	SWCLK; 串行调试编程接口时钟	
8	PA2	I/0	I/O SWDIO; 串行调试编程接口数据	
9	9 PA3 I/O 通用 GPIO		通用 GPIO	
10	PA4	I/0	通用 GPIO	
11	PA5	DO	PA5; UART TXD	
12	PA6	DI	PA6; UART RXD	

#### HM-BT2401DA V1.0

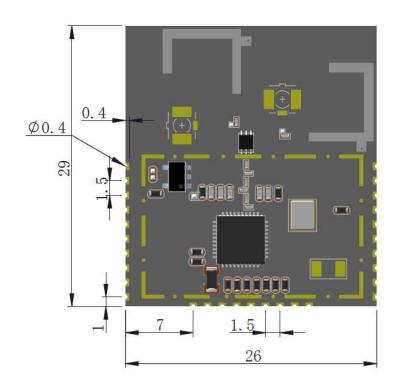
|--|

13	PA7	I/0	通用 GPIO
14	PA8	I/0	通用 GPIO
15	PD3	I/0	通用 GPIO
16	PD2	I/0	通用 GPIO
17	PD1	I/0	通用 GPIO
18	PD0	I/0	通用 GPIO
19	VCC	DV	电源 3. 3V
20	GND	DG	电源地
21	PC0	I/0	通用 GPIO
22	PC1	I/0	通用 GPIO
23	PC2	I/0	通用 GPIO
24	PC3	I/0	通用 GPIO
25	PC4	I/0	通用 GPIO
26	PC5	I/0	通用 GPIO
27	PC6	I/0	通用 GPIO
28	PC7	I/0	通用 GPIO
29	RES	I/0	Reset 复位脚; 低电平有效

表1 模块引脚定义



#### 7 模块尺寸



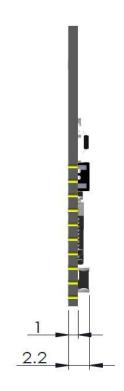


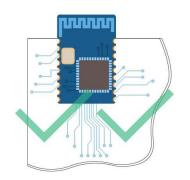
图 4 HM-BT2401DA 模块尺寸图(单位: mm)

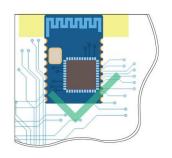
### 8 硬件设计注意事项

- 1、推荐使用直流稳压电源对模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
- 2、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久 性损坏,请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 3、在针对模块设计供电电路时,推荐保留 30%以上余量,有利于整机长期稳定 地工作,模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
- 4、高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在不得已需要经过模块下方,假设模块焊接在Top Layer,在模块接触部分的Top Layer铺地(全部铺铜并良好接地),走线必须靠近模块数字部分,并走线在Bottom Layer;



- 5、假设模块焊接或放置在 Top Layer, 在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度;
- 6、假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽;
- 7、假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线) 也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以 做适当的隔离与屏蔽;
- 8、通信线若使用 5V 电平, 必须使用电平转换电路;
- 9、尽量远离部分物理层亦为 2.4 GHz 频段的 TTL 协议,例如: USB3.0。
- 10、模块天线布局请参考下图:





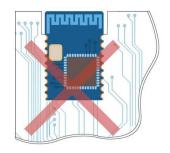


图 5 PCB 走线建议

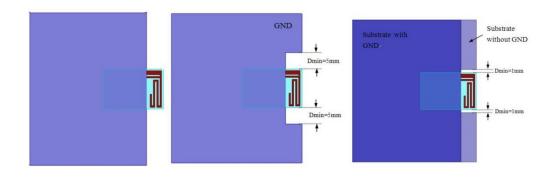


图 6 PCB 布局建议



#### 9 常见问题

#### 9.1 传输距离不理想

- 1、当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高;地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差;
- 2、海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差;
- 3、天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重;
- 4、功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近);
- 5、室温下电源电压低于推荐值,电压越低发射功率越小;
- 6、使用天线与模块匹配程度较差,或天线本身品质有问题。

#### 9.2 易损坏——异常损坏

- 1、请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动;
- 2、请确保安装使用过程中的防静电操作,高频器件为静电敏感器件;
- 3、请确保安装使用过程中湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件;如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

#### 9.3 误码率太高

- 1、附近有同频信号干扰,远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰;
- 2、电源不理想也可能造成乱码, 务必保证电源的可靠性;
- 3、延长线、馈线品质太差或太长,也会造成误码率偏高。



#### 10 回流焊条件

- 1、加热方法: 常规对流或 IR 对流;
- 2、允许回流焊次数: 2次,基于以下回流焊(条件)(见下图);
- 3、温度曲线:回流焊应按照下列温度曲线(见下图);
- 4、最高温度: 245°C。

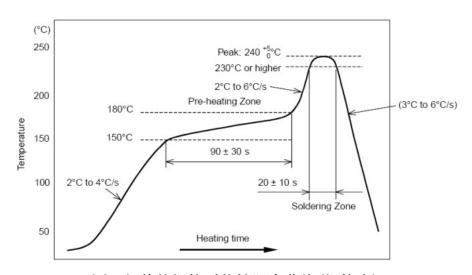


图 7 部件的焊接耐热性温度曲线(焊接点)

### 11 静电放电警示

模块会因静电释放而被损坏,建议所有模块应在以下3个预防措施下处理:

- 1、必须遵循防静电措施,不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限,从而模块会更容易受到损害。



## 12 文档变更记录

表 2. 文档变更记录

文档版本	变更描述	更新日期
V1.0	首次发布	2025.7.14

## 13 联系方式

深圳市华普微电子股份有限公司

地址:深圳市南山区西丽街道万科云城三期 8 栋 A 座 30 层

电话: +86-0755-82973805

邮箱: sales@hoperf.com

网址: http://www.hoperf.cn